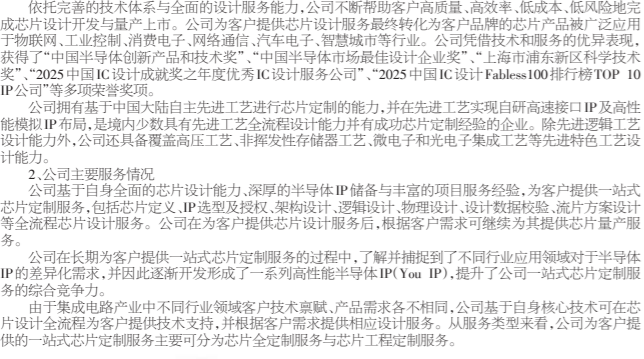


第一节 重要提示
 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
 2. 重大风险提示
 公司在本报告中详细描述了可能存在的风险, 敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分。
 3. 公司控股股东及实际控制人保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
 4. 公司全体董事出席董事会会议。
 5. 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 6. 口占为凭, 不取红利, 不交资本公积。
 7. 董事会审议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
 鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负, 结合相关法律法规, 综合考虑公司目前经营计划和实际情况等因素, 兼顾公司及全体股东的长远利益, 公司 2025 年度不进行利润分配, 不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积转增股本。
 本报告期内, 公司第二届董事会第九次会议审议通过, 尚需提交 2025 年度股东大会审议。
 母公司存在未弥补亏损
 □适用√不适用
 8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
 □适用√不适用
 第二节 公司简介
 一、公司简介
 1.1 公司简称
 √适用□不适用

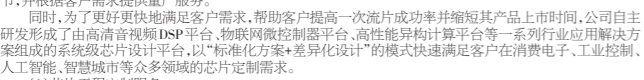
股票简称	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	灿芯股份	688691	不适用

1.2 公司存在担保情况	1.3 联系人和联系方式																												
□适用√不适用	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>联系电话</th> <th>电子邮箱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>沈奕新</td> <td>董事长</td> <td>021-50375685</td> <td>lshyx@stcn.com</td> </tr> <tr> <td>沈奕新</td> <td>董事</td> <td>021-50376620</td> <td>lshyx@stcn.com</td> </tr> <tr> <td>沈奕新</td> <td>董事</td> <td>021-50375685</td> <td>lshyx@stcn.com</td> </tr> <tr> <td>沈奕新</td> <td>董事</td> <td>021-50376620</td> <td>lshyx@stcn.com</td> </tr> <tr> <td>沈奕新</td> <td>董事</td> <td>021-50375685</td> <td>lshyx@stcn.com</td> </tr> <tr> <td>沈奕新</td> <td>董事</td> <td>021-50376620</td> <td>lshyx@stcn.com</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	职务	联系电话	电子邮箱	沈奕新	董事长	021-50375685	lshyx@stcn.com	沈奕新	董事	021-50376620	lshyx@stcn.com	沈奕新	董事	021-50375685	lshyx@stcn.com	沈奕新	董事	021-50376620	lshyx@stcn.com	沈奕新	董事	021-50375685	lshyx@stcn.com	沈奕新	董事	021-50376620	lshyx@stcn.com
姓名	职务	联系电话	电子邮箱																										
沈奕新	董事长	021-50375685	lshyx@stcn.com																										
沈奕新	董事	021-50376620	lshyx@stcn.com																										
沈奕新	董事	021-50375685	lshyx@stcn.com																										
沈奕新	董事	021-50376620	lshyx@stcn.com																										
沈奕新	董事	021-50375685	lshyx@stcn.com																										
沈奕新	董事	021-50376620	lshyx@stcn.com																										

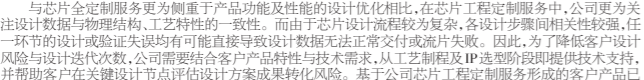
2. 报告期间公司主要业务简介
 2.1 主要业务产品或服务情况
 一、公司主营业务情况
 公司专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务业务。公司定位于新一代信息技术领域, 自成立以来一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务, 并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与主导 IP 开发为核心的全价值链服务能力。
 依托完善的技术体系与全面的设计服务能力, 公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片定制开发需求。上市公司为客户提供一站式芯片定制服务, 实现从芯片设计到量产交付的全流程支持, 包括芯片设计、IP 设计、封装及测试、流片、封装、测试、量产交付等各个环节。公司凭借技术优势, 获得了“2025 中国 IC 设计成就奖之年度优秀 IC 设计公司”、“2025 中国 IC 设计 Fabless100 排行榜 TOP 10 IP 公司”等多项荣誉奖项。
 公司专注于自主设计先进工艺制程芯片定制服务, 并在先进工艺制程自主研发接口 IP 及高性能 IP 架构布局, 是国内少数具备先进工艺制程芯片定制服务能力和先进工艺制程芯片定制设计能力, 同时具备先进封装工艺、非挥发性存储器工艺、微电子和光子集成电路工艺等先进特色工艺设计能力的公司。
 公司在长期为客户提供一站式芯片定制服务的过程中, 了解并积累了不同行业应用领域的芯片定制 IP 的差异化竞争力, 并因此逐渐开发形成了一系列高性能半导体 IP (IP 库), 提升了公司一站式芯片定制服务的综合竞争力。
 由于集成电路产业不同行业领域客户技术需求、产品需求各不相同, 公司作为自身核心技术可在芯片设计全流程为客户提供技术支持, 并根据客户需求提供定制化服务。从服务类型来看, 公司为客户提供的一站式芯片定制服务主要分为 SoC 定制服务和 IP 定制服务。



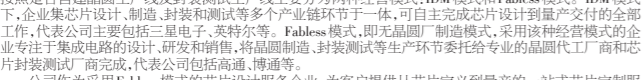
(1) 芯片定制服务
 芯片定制服务是指公司根据客户对于芯片功能、性能、功耗、面积、应用适应性要求, 借助自身全面的芯片设计能力及丰富的设计经验, 根据客户需求完成芯片定义、IP 及工艺选型、架构设计、前端设计验证、封装测试、量产交付等全流程支持, 为客户提供一站式芯片定制服务。该服务覆盖芯片设计、封装、测试、量产交付等各个环节, 并根据客户需求提供定制化服务。
 同时, 为了更快捷地满足客户需求, 帮助客户提高一次流片成功率并缩短芯片上市时间, 公司自主研发形成了高兼容视频 IP 库、高性能图像处理 IP、高性能图形计算平台等一系列行业应用解决方案, 赋能客户芯片设计平台, 以标准化、差异化设计的方式快速满足客户在消费电子、工业控制、人工智能等领域对定制化芯片的需求。
 (2) 芯片 IP 定制服务
 芯片 IP 定制服务主要是指公司根据客户需求, 完成工艺制程及半导体 IP 选型、定制设计验证、IP 封装、封装测试、流片方案设计及工艺裕量优化, 系统性评估及交付、封装及测试验证、测试服务、量产交付等全流程支持, 并根据客户需求提供定制化服务。
 与芯片定制服务更为侧重于产品功能及性能的设计交付相比, 在芯片 IP 定制服务中, 公司更多关注设计验证与物理实现、工艺特性的一致性, 而由于芯片设计流程较为复杂, 各设计阶段间相关性较强, 任一环节的验证不足均可能导致量产交付失败, 因此, 公司为了降低客户芯片设计风险, 并提高客户芯片设计效率, 在芯片 IP 定制服务中, 公司更多关注设计验证与物理实现、工艺特性的一致性, 并帮助客户在关键设计节点提供设计方方案及数据验证。基于公司芯片定制服务形成的客户产品已广泛应用于消费电子、高性能工业控制、人工智能等领域。
 2.2 定制服务模式
 一、公司商业模式概述
 公司商业模式为集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造和封装测试等环节组成。集成电路业务按照是自建晶圆生产线及封装测试生产线主要分为两种经营模式: IDM 模式和 Fabless 模式。IDM 模式, 企业集芯片设计、制造、封装测试等多个产业链环节于一体, 可自主完成芯片到量产交付的全部工作, 代表企业主要有三星电子、英特尔等。Fabless 模式, 即无晶圆厂制造模式, 采用定制经营模式的企业专注于集成电路的设计、研发和封装测试, 将晶圆制造、封装测试等生产环节交给专业的晶圆代工/封装测试厂商完成, 代表企业包括高通等。
 公司作为无晶圆厂 Fabless 模式的芯片设计服务企业, 为客户提供从芯片定制服务的一站式芯片定制服务。在定制服务模式中, 公司与同样采用 Fabless 模式的芯片设计公司亦存在一定竞争。公司作为芯片设计服务企业, 并不通过销售自有产品实现收入, 而是通过自主 IP 及 SoC 开发能力为客户提供芯片设计产品及系统 IP 定制服务, 帮助客户提高一次流片成功率, 降低客户库存积压风险。公司依托自身核心技术为客户提供一站式芯片定制服务, 最终转化为客户品牌的产品竞争力。
 二、经营策略及平台优势
 1. 可规模化的特点: 定制服务模式使得公司集中资源于可复用、高价值、具备竞争优势的技术平台, 通过持续输出技术能力, 帮助客户完成芯片开发及量产, 形成了较高应用领域的技术壁垒。
 2. 盈利模式
 公司作为典型的集成电路设计服务企业, 主要通过向客户提供芯片设计服务并依据其产品需求提供芯片量产服务以获取收入和利润。报告期内, 公司主营业务收入均来自于一站式芯片定制服务。
 3. 研发模式
 公司一站式芯片定制服务研发方向包括应用于公司系统级芯片设计平台与高性能半导体 IP 的研发。
 (1) 系统级芯片设计方面的流程
 公司系统级芯片设计方面主要根据客户对市场需求分析, 针对行业应用领域功能、性能、面积等需求, 结合自身第三 IP 自主开发能力对可复用系统级芯片方案并应用于客户项目内部, 主要环节如下:
 ①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 (2) 半导体 IP 研发流程



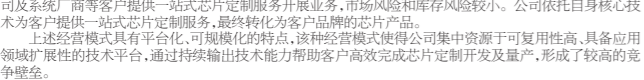
公司系统级芯片设计方面主要根据客户对市场需求分析, 针对行业应用领域功能、性能、面积等需求, 结合自身第三 IP 自主开发能力对可复用系统级芯片方案并应用于客户项目内部, 主要环节如下:
 ①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



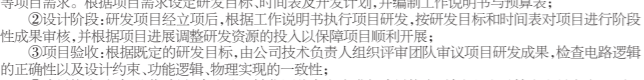
①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



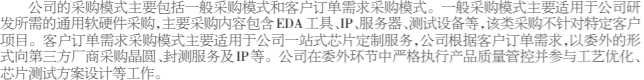
①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



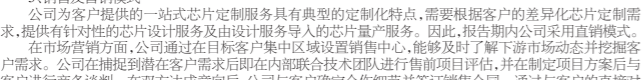
①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



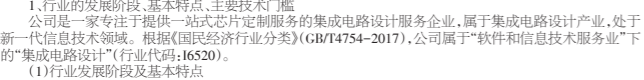
①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



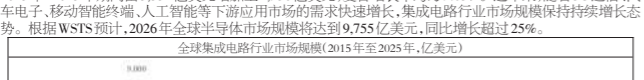
①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



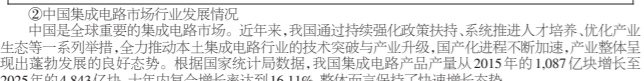
①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



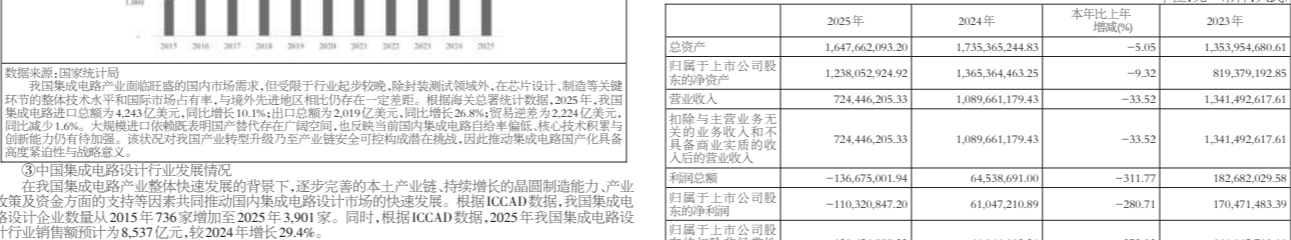
①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;



①项目启动: 客户提出需求, 双方进行需求分析, 制定需求规格书, 收集需求规格书, IP 设计方法等需求, 根据项目启动需求制定项目、制定交付计划, 并编制工作分解表;
 ②需求分析: 研发团队根据需求, 根据工作分解表执行项目需求, 按项目目标制定项目启动阶段功能需求, 并制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ③需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;
 ④需求验证: 研发团队根据需求, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书, 制定项目启动阶段的功能需求规格书;

灿芯半导体(上海)股份有限公司

公司代码: 688691	公司简称: 灿芯股份
--------------	------------



数据来源于国家统计局
 2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。



数据来源于 IC 设计行业数据
 2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。

2025 年度, 我国集成电路设计行业再次迎来高速增长, 人工智能、汽车电子等下游应用领域快速发展, 带动集成电路设计行业整体景气度持续提升。根据 IC 设计行业数据, 2025 年我国集成电路设计行业新增营收预计为 8,537.72 亿元, 较 2024 年增长 20.4%。